



Feature 特点

- 无卤素 T_g(DSC) 150°C 低Z-CTE
- UV Blocking/AOI兼容
- 无铈, 无卤含量符合要求
- 优良耐热性
- 优良通孔可靠性
- 优良耐CAF性能
- Halogen-free T_g(DSC) 150°C LOW Z-CTE
- UV Blocking/AOI Compatible
- Antimony-free, Halogen-free
- Excellent Thermal Reliability
- Excellent PTH Reliability
- Excellent Anti-CAF Performance

Application 应用

- 计算机、液晶显示器、仪器仪表、通讯设备、汽车等
- Computer, LCD, Instrument, Communication Equipment, Automotive etc.
- HDI应用
- HDI Applications

Feature 特点

Base Color 基板颜色	Thickness 厚度	Copper Thickness 铜箔厚度	Regular Size 常规尺寸
Yellow 黄色	0.05~1.6 mm	1oz~2oz	2082*1245mm (82*49) 1092*1245mm (43*49) 2184*1245mm (86*49)

Note: Other sheet size and thickness could be available upon request.
可根据客户要求提供其他尺寸和厚度

General Properties 一般特性

测试项目 Test Item	单位 Unit	测试方法 Test Condition (IPC-TM-650)	处理条件 Treatment Condition	规格值 Specification	典型值 Typical Value	
玻璃态转化温度 T _g (DSC)	°C	2.4.25	E-2/105	≥150	160	
剥离强度 (35um) Peel Strength	N/mm	2.4.8	热应力后 (Float 288°C/10sec)	≥1.05	1.57	
热应力 (288°C) Thermal Stress	Sec	2.4.13.1	未蚀刻	≥30	>240	
介电常数 (RC50%) Permittivity	1GHZ	-	2.5.5.9	C24/23/50	≤5.0	4.85
介电损耗 (RC50%) Loss Tangent	1GHZ	-	2.5.5.9	C24/23/50	≤0.030	0.011
体积电阻率 Volume Resistivity	MΩ-cm	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1X10 ⁶	2.9x10 ⁹	
表面电阻率 Surface Resistivity	MΩ	2.5.17.1	C-96/35/90	≥1X10 ⁴	5.9x10 ⁷	
电气强度 Electric Strength	KV/mm	2.5.6.2	D-48/50+ D-0.5/23	≥30	56	
耐电弧 Arc Resistance	Sec	2.5.1	D-48/50+ D-0.5/23	≥60	181	
弯曲强度 Flexural Strength	LW经向	N/mm ²	2.5.6	D-48/50+D-0.5/23	≥40	46
	CW纬向				≥415	583
击穿电压 Dielectric Breakdown	KV	2.4.4	常态A	≥345	452	
吸水率 Absorption	Water %	2.6.2.1	D-24/23	≤0.5	0.11	
Z轴膨胀系数 CTE Z-Axis	Before T _g	2.4.24	E-2/105	≤60	29	
	After T _g			≤300	215	
	50~260°C			≤3.5	2.43	
热分层时间 Thermal stratification	T260	2.4.24.1	蚀刻, E-2/105	≥30	>60	
	T288			≥5	60	
热分解温度 Td	Weight Loss 5%	2.4.24.6	E-2/110	≥325	372	
燃烧性E Flammability	Rating	UL94	E-24/125+DES	V-0	V-0	
相对漏电起痕指数 CTI	-	IEC-60112	常态A	PLG3	PLG3	

Specification sheet: IPC-4101/128, for reference only.